

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成20年5月19日（月）10:00～16:30

場所 電気学会会議室（東京都千代田区五番町6-2 HOMATHORIZONビル8階，JR総武線（中央線各駅停車）市ヶ谷駅下車，徒歩2分，東京メトロ有楽町線・南北線，都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅下車，3番出口より徒歩2分

<http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/31-doc-honb/map.pdf>)

テーマ「シームレス実装技術と三次元実装技術」

委員会解散にあたって

大場隆之（東京大学）…………… 1

EFM-08-17 集積化CMOS-MEMS技術とその応用

町田克之，森村浩季，石井 仁，武藤伸一郎（NTTアドバンステクノロジー）…………… 3

EFM-08-18 3D Interconnect 向け Si エッチング技術

阿部祐一（東京エレクトロン）

丸山幸児，平山祐介，永関一也（東京エレクトロンAT）……………9

EFM-08-19 Deep Silicon Etch for TSV application - for increased performance and productivity

Sharma Pamarthy, Jon Farr, Khalid Sirajuddin, A jay Kumar（Applied Materials, Inc.）…………… 13

EFM-08-20 3D-SiP向けシリコン貫通電極技術

田中直敬，吉村保廣，川下道宏（日立機械研）

植松俊英，内藤孝洋，赤沢 隆（ルネサステクノロジー）…………… 17

EFM-08-21 超臨界流体を用いたCu薄膜堆積

～成膜特性検討と貫通電極プロセスへの適用の試み

松原正弘，近藤英一（山梨大学）…………… 23

EFM-08-22 SiP向けウェーハ研削技術

増地純郎（ディスコ）…………… 27

EFM-08-23 絶縁膜とビアポストの同時研削を用いた多層配線技術

谷 元昭, 中川香苗, 水越正孝 (富士通研究所) …………… 33

協 賛 U L S I ・実装インターコネク ト材料技術調査専門委員会